2026-05-12

COMMENT

IT 하드웨어 (기판)

대덕전자, 기판 증설 관련 코멘트

IT 하드웨어/배터리. 박형우, R.A 정영환 / hyungwou@sks.co.kr / 3773-9035

Signal: 대덕전자 투자 공시, CSP & 메모리기판 증설
Key: 향후 장비투자 및 FCBGA 투자 추가 발표 예상
Step: 하반기, 기판 투자싸이클 본격화 전망 (기판&장비)

신규 시설 투자 공시(2026/05/11)

- 투자금액 2,130 억원
- 투자기간 2026 년 5 월 ~ 2027 년 12 월

주요 투자 내용

- 투자 대상: 메모리 및 CSP 사업부
- FCBGA 는 이번 공시에 미포함. 기존 공장 활용한 별도 투자 가능하며, 투자 결정 시 별도 발표 예정
- 이번 공시는 부지 매입 및 공장 증축·부대시설 투자분만 포함
- 재원은 보유 자금 및 일부 차입으로 조달
- LTA 지원 투자방식 X
- 장비 매입 규모는 미확정. 한두 달 내 별도 발표 계획
- 순차적 장비 반입 방식으로 진행. 라인 전체 일괄 투자 아님

애널리스트 의견

- 지난 1Q26 IR 실적발표에서 메모리 및 MSAP 라인 공장 증설을 1 순위 투자로 공언한 바 있음
- 이번 공시는 그 공식화
- FCBGA 낙수효과로 MSAP 기판 및 일부 메모리기판도 준쇼티지 진입
- 장비 투자 규모 미확정으로 CAPA 증가 폭은 추후 확인 필요. 고객 수요에 따른 점진적 증설 가능
- 증설 효과는 이르면 27 년 하반기부터 실적 반영 전망
- 전방 수요 호조 지속된다면, 기판 가격 상향흐름 지속될 것
- 5 년 전 싸이클 당시 패키징기판 산업 내 제품별 ASP 는 약 2 년 동안 50~150% 상승 (동일제품 기준)
- 향후 FCBGA 투자 공시는 추가 성장동력으로 작용 기대
- 하반기, 기판 투자싸이클 본격화 전망

COMMENT

COMPLIANCE NOTICE

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3 단계(6 개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2026 년 05 월 12 일 기준)	매수	93.90%	중립	6.10%	매도	0.00%